

KLA 引入全新芯片制造量测系统

助力高性能逻辑及存储芯片制造

加利福尼亚州米尔皮塔斯市，2020年2月24日/美通社/-今天，[KLA 公司](#)（纳斯达克股票代码：KLAC）宣布推出 Archer™ 750 基于成像技术的套刻量测系统和 SpectraShape™ 11k 光学临界尺寸（“CD”）量测系统，它们的主要应用是集成电路（“IC”或“芯片”）制造。在构建芯片中的每一层时，Archer 750 有助于验证特征图案是否与前层对应结构图形对准，而 SpectraShape 11k 则帮助监控三维结构的形状，例如晶体管和存储单元，确保它们符合规格要求。通过识别图案对准或特征形状的细微变化，这些新的量测系统可帮助 IC 制造商严格控制所需的复杂制程，将高性能存储器和逻辑芯片推向市场，并应用在 5G，AI，数据中心和边缘计算等领域。

KLA 量测部门高级副总裁兼总经理 Jon Madsen 表示：“IC 制造商面临着以原子尺度衡量的制程容差，因为他们将新颖的结构和新材料集成到了先进的芯片中。”“KLA 在确保以高性价比制造高质量标准的芯片产品方面发挥着关键作用。今天，我很自豪地宣布我们的量测解决方案产品组合中的两大新增成员，它们是一支由工程师和科学家组成的一流多学科团队的辛勤工作和创造性思维的结晶。新的 SpectraShape 11k 和 Archer 750 系统为我们的晶圆厂客户带来了急需的制程控制功能，帮助他们生产创新的电子产品，从而推动我们的世界前进。”

在制程存在变化的情况下，Archer 750 套刻量测系统可以提供准确可靠的套刻误差测量结果，同时可以实现的产能也是仅在基于散射测量的套刻系统上才能看到的水平。这一突破性的系统可在各个层之间提供准确，快速的反馈，从而帮助光刻机在线识别制程偏差并改善整体图案完整性，从而更快地提高良率，更稳定地生产高级逻辑，DRAM 和 3D NAND 器件。

SpectraShape 11k CD 和尺寸形状量测系统是将灵敏度和生产率进行了前所未有的结合，可容纳以前无法涉及材料、结构和晶片形状。SpectraShape 11k 具有以高精度和高速度测量高级逻辑、DRAM 和 3D NAND 器件功能的能力，可快速识别制程问题并在生产过程中进行严格的制程监控。

全新量测系统及可实现更高性能的技术突破的更多信息，请参见[产品组合](#)信息页面。

众多的 Archer 750 和 SpectraShape 11k 系统均已通过应用鉴定，并已在全球领先的 IC 制造商中投入使用，在应用于生产创新电子设备的许多制程步骤中，它们提供的关键反馈。Archer 750 和 SpectraShape 11k 与 KLA 的 [5D Analyzer®](#) 高级数据分析系统集成在一起，该系统支持实时制程控制及工程监控与分析。为了维持芯片制造商所要求的高性能和生产率，Archer 750 和 SpectraShape 11k 量测系统得到了 [KLA 全球综合服务网络](#) 的支持。

关于 KLA 公司：

KLA 开发了行业领先的设备与服务，帮助实现整个电子行业的创新。我们提供先进的制程控制和支持解决方案，用于制造晶圆和掩模版，集成电路，封装，印刷电路板和平板显示器。通过与全球领先客户的紧密合作，我们的物理学家，工程师，数据科学家与问题解决专家团队将设计解决方案，推动世界向前发展。有关更多信息，请访问 www.kla.com (KLAC-P)。

前瞻性声明：

除历史事实外，本新闻稿中的陈述属于前瞻性陈述，例如关于 Archer 750 和 SpectraShape 11k 系统的预期性能以及晶片、设备、材料和芯片制造设施的量测学测量的经济影响的陈述，以及受《1995 年私人证券诉讼改革法案》所制定的“安全港”条款的约束。这些前瞻性声明基于当前的信息与期望，并涉及风险和不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题还是其他原因），其他公司推出竞争产品或意外的技术挑战或局限性，实际结果可能与此类声明中的预期结果产生重大出入。会影响 KLA 产品的实施、性能或使用。

投资关系：Kevin Kessel, CFA, 投资关系副总裁, (408) 875-6627, kevin.kessel@kla.com;

媒体关系：Randi Polanich, 首席传讯官, (408) 875-6633, randi.polanich@kla.com